KGK Chemical Corp.

#1 Coating Technology in The World
Molecule Gradient Layer (MGL)™ Technology

내열이미드 기재 반도체 칩 고정용 테이프

278

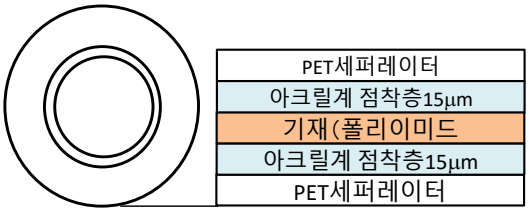
특징

① 납땜 내열성 폴리이미드 필름을 기재로 한 내열양면 테이프
②글라스·반도체에 찐이 남지 않는 우수성
③우수하고 뛰어난 장기적 내열성

용도

자동차의 엔진 주변이나 항공우주기기 등의 부품 고정

구성



특성

일반특성

제품명	(기재두께) (mm)	(점착두께) (mm)	점착력 (N/25mm)
278	0.075	0.030	5

측정조건 (JIS Z0237준거) 인장속도 300mm/min, 인장각도 180도, 측정온도 23℃
접합후、1시간 이후 측정 값
피착체 스텐레스 판

사용 상의 주의

●기술자료는 모두 공동기연화학㈜의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다。
단、제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다。
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다。
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다。
●상기측정은 실온(23℃)하에서 이뤄진 데이터 입니다。저온(5℃이하)의 경우 점착력은 급격하게 저하하는 경우가 있습니다。

보관 상의 주의

●반드시 상자에 넣어 보관하여 주십시오。
●보관조건에 의한 특성저하가 일어날 수 있습니다。
●보관장소는 직사광선이 닿지 않는 곳으로 서늘한 곳으로 하여 주십시오。
특히 고온고습(온도 30℃이하 습도50%이하 엄수)에 노출되지 않도록 하여 주십시오.。

2020年5月22日 発行

共同技研化学株式会社
〒359-0011
埼玉県所沢市南永井940番地
℡ 04-2944-5151
Mail: info-k@kgk-tape.co.jp
URL: https://www.kgk-tape.co.jp/